



## W H I T E P A P E R

# EU Chips Act 2.0:

## Was OEMs jetzt wissen müssen

*Neue Beschaffungsregeln, Versorgungssicherheit und strategische Konsequenzen für die Elektronikfertigung*

**Dirk Kaussen, MBA**

Gründer und Geschäftsführer, EMS Strategy Group | 17. Juni 2026

### Kernaussage

Am 3. Juni 2026 veröffentlichte die Europäische Kommission den Vorschlag für den Chips Act 2.0 [1]. Er enthält erstmals nachfrageseitige Maßnahmen: Öffentliche Ausschreibungen in kritischen Sektoren sollen zukünftig den EU-Mehrwert in der Halbleiterlieferkette der Bieter berücksichtigen. Für OEMs, die öffentliche Auftraggeber oder kritische Infrastrukturbetreiber beliefern, ist das ein regulatorisches Signal, das Handlungsbedarf auslöst — noch bevor das Gesetz in Kraft tritt.

## 1. Hintergrund: Warum ein Chips Act 2.0?

Der originale European Chips Act (2023) war die erste koordinierte Antwort der EU auf kritische Schwachstellen in der globalen Halbleiterlieferkette. Laut Europäischer Kommission mobilisierte der European Chips Act mehr als 52 Milliarden Euro an öffentlichen und privaten Investitionen und schuf geschätzte 46.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze [2].

Trotz dieser Fortschritte bleibt die EU in Schlüsselbereichen abhängig: bei der Fertigung fortschrittlicher Chips und beim Halbleiterdesign sind europäische Unternehmen nach wie vor auf Lieferanten aus Drittstaaten angewiesen. Laut PwC könnte der globale Halbleitermarkt bis 2030 ein Volumen von über 1 Billion US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von rund 8,6 % entspricht. Als wesentliche Wachstumstreiber gelten insbesondere Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz, Rechenzentren und High-Performance Computing (HPC) [6].

Der am 3. Juni 2026 vorgelegte Chips Act 2.0 ist Teil des von der Europäischen Kommission vorgestellten "European Technology Sovereignty Package" [3] der Kommission und ergänzt den Cloud and AI Development Act sowie eine EU-Open-Source-Strategie. Er verschiebt den Schwerpunkt: weg von reiner Angebotsförderung, hin zu nachfrageseitigen Steuerungsinstrumenten.

## 2. Kerninhalt des Chips Act 2.0

Der Vorschlag gliedert sich in vier strategische Zielrichtungen:

### Vier Säulen des Chips Act 2.0 (Vorschlag vom 3. Juni 2026)

- ▶ Säule 1 — Investitions- und Wettbewerbsbedingungen: Forschungsförderung, vereinfachte Genehmigungsverfahren (max. 12 Monate), "Grand Challenges" für Schlüssel-Chips wie KI-Prozessoren
- ▶ Säule 2 — Nachfrageförderung: Demand Accelerators, öffentliche Beschaffung mit EU-Mehrwertkriterien, Innovationsbeschaffung für europäische Startups
- ▶ Säule 3 — Angebotsausbau: Staatliche Beihilfen für "First-of-a-Kind"-Projekte, Strategische Projekte mit EU-Kofinanzierung, neue Semiconductor Regions of Excellence
- ▶ Säule 4 — Resilienz und Abhängigkeitsreduktion: Business-to-Business Semiconductor Supply Chain Platform, Risikobewertungs-Leitfäden, strukturierte Krisenreaktion

### 2.1 Die neue Beschaffungsdimension

Die für OEMs und deren Lieferketten potenziell am intensivsten wirkende Neuerung liegt in Säule 2. Der Vorschlagstext sieht vor, dass öffentliche Ausschreibungen in kritischen Bereichen künftig den EU-Mehrwert in der Halbleiterversorgung der Bieter berücksichtigen können bzw. berücksichtigen sollen [1][2]. Nach aktuellem Entwurfsstand könnte dies bedeuten, dass Vergabestellen Bieter um Nachweise ihrer Versorgungssicherheit bitten können [1][2] — einschließlich Angaben zum Anteil europäischer Lieferanten und zur Dual-Sourcing-Strategie.

### Wichtiger Hinweis zum Status des Vorschlags

Der Chips Act 2.0 ist ein Legislativvorschlag — noch kein geltendes Recht. Er muss den vollständigen europäischen Gesetzgebungsprozess durch Parlament und Rat durchlaufen. Der endgültige Text kann von dem abweichen, was aktuell im Entwurf steht. Nach Annahme würden die Beschaffungsanforderungen für Ausschreibungen gelten, die mindestens ein Jahr nach Inkrafttreten gestartet werden. OEMs haben also ein Zeitfenster zur Vorbereitung.

### 3. Welche OEMs sind betroffen?

---

Die Beschaffungsregelungen des Vorschlags zielen nach aktuellem Entwurfsstand auf Vergabeverfahren in Sektoren ab, die als kritisch eingestuft sind. OEMs, die in folgenden Bereichen Produkte oder Systeme an öffentliche Auftraggeber oder Betreiber kritischer Infrastruktur liefern, sollten das Thema prioritär bearbeiten:

- Energie (Netz, erneuerbare Energien, Speicher)
- Verkehr und Mobilität (Bahn, Luft, autonome Systeme)
- Gesundheitswesen (Medizingeräte, Diagnose, Krankenhaustechnik)
- Digitale Infrastruktur (Rechenzentren, Telekommunikation, Cloud)
- Verteidigung und Sicherheit
- Industrieautomation in strategischen Sektoren

Auch OEMs, die nicht direkt öffentliche Auftraggeber beliefern, können mittelbar betroffen sein: Wenn ihre Tier-1-Kunden in diesen Sektoren aktiv sind, wird die Anforderung durch die Wertschöpfungskette weitergegeben werden.

### 4. Chancen für OEMs mit europäisch ausgerichteter Lieferkette

---

Der Chips Act 2.0 könnte für OEMs, die bereits auf europäische EMS-Partner und Dual-Sourcing-Strukturen setzen, perspektivisch konkrete Wettbewerbsvorteile bei öffentlichen Vergaben eröffnen:

#### 4.1 Differenzierungsmerkmal bei Ausschreibungen

Sollte der EU-Mehrwert in der Halbleiterkette als Zuschlagskriterium bestätigt werden, könnte dies einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Bietern mit rein asiatischer Zulieferbasis schaffen. Ein OEM, der bereits über eine dokumentierte europäische Dual-Sourcing-Strategie verfügt, könnte in solchen Verfahren einen Wettbewerbsvorteil erzielen, der über reine Preisaspekte hinausgeht.

#### 4.2 Frühzeitige Marktpositionierung

Die Übergangszeit bis zur Anwendung der Verordnung (voraussichtlich ein Jahr nach Inkrafttreten) gibt OEMs ein Zeitfenster, ihre Lieferkette proaktiv zu dokumentieren, europäische Partner zu qualifizieren und die entsprechenden Nachweise vorzubereiten — bevor Wettbewerber reagieren.

#### 4.3 Signalwirkung auf Beschaffungsverhalten

Auch unabhängig von einer rechtlichen Verpflichtung: Es ist zu erwarten, dass sich öffentliche Auftraggeber und Industrieunternehmen zunehmend an den Leitlinien der europäischen Technologie- und Halbleiterpolitik orientieren werden. Eine nachweisbare europäische Lieferkette könnte dadurch zunehmend als zusätzliches Auswahlkriterium an Bedeutung gewinnen.

## 4.4 Zugang zu strategischen Programmen

Der Chips Act 2.0 sieht die Einrichtung einer Business-to-Business Semiconductor Supply Chain Platform vor. Unternehmen, die sich frühzeitig vernetzen und ihre Resilienzmaßnahmen dokumentieren, könnten von einem früheren Zugang zu Informationen, Markttransparenz und potenziellen Kooperationsangeboten profitieren.

## 5. Herausforderungen und Risiken

---

### 5.1 Regulatorische Unsicherheit

Der Vorschlag ist noch kein Gesetz. Bis zur finalen Verabschiedung durch Parlament und Rat können Formulierungen, Schwellenwerte und Anforderungen erheblich verändert werden. OEMs, die ihre Lieferkette aufwendig auf bestimmte Vorschlagskriterien ausrichten, gehen ein Anpassungsrisiko ein.

### 5.2 Nachweis- und Dokumentationsaufwand

Eine belastbare "Versorgungssicherheitserklärung" — sofern in der finalen Fassung so vorgesehen — erfordert die systematische Erfassung der Halbleiterherkunft in der Lieferkette. Für viele OEMs fehlt diese Transparenz bislang. Die Datenerhebung bindet Ressourcen, insbesondere in der Beschaffung und im Lieferantenmanagement.

### 5.3 Verfügbarkeit europäischer Halbleiterquellen

Die europäische Halbleiterfertigung deckt trotz der Fortschritte durch den ersten Chips Act nicht alle Technologieklassen ab. Für hochkomplexe Logikchips und Leading-Edge-Prozessoren bestehen weiterhin strukturelle Abhängigkeiten von führenden außereuropäischen Herstellern wie TSMC (Taiwan) und Samsung (Südkorea) [2][4]. Eine vollständig europäische Halbleiterbasis ist für viele OEMs in absehbarer Zeit nicht realisierbar.

### 5.4 Kostenstruktur

Europäische Halbleiterfertigung ist in der Regel teurer als asiatische Alternativen. Eine Verlagerung hin zu EU-basierten Quellen beeinflusst die Kostenstruktur des Produkts. OEMs müssen abwägen, ob der Vorteil bei öffentlichen Ausschreibungen diesen Mehraufwand kompensiert — eine Kalkulation, die stark vom jeweiligen Markt und Auftragsvolumen abhängt.

### 5.5 Keine rückwirkende Anforderung

Die Regelung gilt laut Vorschlag für neue Ausschreibungen nach Ablauf der Übergangsfrist. Bestehende Verträge und laufende Serienbeziehungen sind nicht betroffen. Der Handlungsdruck entsteht also schrittweise, mit messbarem Vorlauf.

## 6. Eine strukturelle Schwachstelle, die der Chips Act 2.0 nicht löst

Der Chips Act 2.0 stärkt die Nachfrage nach europäischen Komponenten und Lieferketten. Doch diese Nachfrage trifft auf ein Angebot, das durch eine vorgelagerte Strukturschwäche der EU-Handelspolitik geschwächt ist — und die mit dem Chips Act nichts zu tun hat.

### Die EU-Zollasymmetrie bei Leiterplatten — bekannt, ungelöst

Fertige Leiterplatten (PCBs) aus China werden in die EU zollfrei importiert — gedeckt durch das WTO Information Technology Agreement (ITA). Gleichzeitig entrichten europäische PCB-Hersteller auf Rohstoffe und Substrate (Laminate, Kupferfolien, Prozesschemikalien) Importzölle von bis zu 6,5 %.

Das Europäische Parlament hat die Kommission bereits im Juli 2023 im Rahmen der Prioritätsfrage P-002327/23 auf diese Asymmetrie hingewiesen [8]: Die bestehende Zollstruktur untergrabe das eigene Ziel der strategischen Autonomie. In ihrer Antwort verwies die Kommission auf laufende Gespräche mit der Industrie, kündigte jedoch keine konkrete Reform der Zollstruktur an. Im Vergleich dazu erhebt die USA Importzölle von bis zu 25 % auf fertige PCBs aus China.

Für OEMs bedeutet das: Der Chips Act 2.0 kann den Wunsch nach europäischer Beschaffung regulatorisch stärken — aber die strukturellen Kostennachteile europäischer PCB-Hersteller gegenüber der zollfreien asiatischen Konkurrenz bestehen fort. Beide Themen sind unabhängig voneinander, und beim zweiten ist keine Lösung absehbar.

## 7. Lösungsansätze: Was OEMs jetzt tun können

Unabhängig vom finalen Gesetzestext sind die folgenden Maßnahmen sowohl bei Inkrafttreten als auch ohne entsprechende Verpflichtung sinnvoll — und stärken die Wettbewerbsfähigkeit:

### 7.1 Lieferkettentransparenz herstellen

Der erste Schritt ist eine Bestandsaufnahme: Welche Halbleiterkomponenten werden von welchen Herstellern in welchen Ländern bezogen? Diese Transparenz ist die Grundlage jeder Versorgungssicherheitsstrategie — und fehlt bei vielen OEMs noch auf Tier-2- und Tier-3-Ebene.

### 7.2 Dual-Sourcing-Strategie entwickeln

Für kritische Komponenten kann die Identifikation eines zweiten, möglichst geografisch diversifizierten Bezugswegs sinnvoll sein — auch wenn er zunächst keine Serienvolumina abdeckt. Ein qualifizierter europäischer Alternativlieferant ist ein nachweisbarer Schritt in Richtung Versorgungssicherheit.

### 7.3 EMS-Partner mit europäischer Basis einbinden

Die Wahl des Fertigungspartners beeinflusst unmittelbar den EU-Mehrwert in der Lieferkette. Ein EMS-Partner mit Fertigung in der EU, europäischen Beschaffungsquellen und etablierten Dual-Sourcing-Prozessen trägt erheblich zur Nachweisführung bei.

### 7.4 Frühzeitig dokumentieren

OEMs sollten schon heute damit beginnen, relevante Lieferkettendaten systematisch zu erfassen: Herkunftsländer von Chips und Bauteilen, Anteil EU-basierter Zulieferer, bestehende Dual-Sourcing-Verträge. Diese Dokumentation ist eine unmittelbare Vorbereitung auf künftige Ausschreibungsanforderungen.

### 7.5 Regulatorischen Prozess beobachten

Der Gesetzgebungsprozess im Europäischen Parlament und im Rat wird voraussichtlich mehrere Monate dauern. OEMs in betroffenen Sektoren sollten die Entwicklung über offizielle Quellen der Europäischen Kommission verfolgen und ihre Strategie auf Basis des finalen Textes justieren.

## 8. Gegenüberstellung: Chancen und Risiken

Chancen	Risiken / Herausforderungen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wettbewerbsvorteil bei EU-Ausschreibungen in kritischen Sektoren</li> <li>• Strategischer Vorlauf durch frühzeitige Lieferkettenanpassung</li> <li>• Differenzierung gegenüber rein asiatisch versorgten Wettbewerbern</li> <li>• Stärkere Resilienz durch Dual-Sourcing und europäische Partner</li> <li>• Signalwirkung auch ohne formalen Zwang bei Großkunden</li> <li>• Zugang zu EU-B2B-Plattform und Frühwarnsystemen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorschlag noch kein Gesetz — Änderungen im Verfahren möglich</li> <li>• Strukturelle Lücken in europäischer Halbleiterfertigung bleiben</li> <li>• Zollasymmetrie auf PCB-Rohstoffe besteht fort — keine Reform absehbar</li> <li>• Dokumentations- und Qualifizierungsaufwand nicht trivial</li> <li>• Kostennachteil bei rein preisgetriebenen Vergaben bleibt</li> <li>• Nur für OEMs relevant, die kritische Sektoren bedienen</li> </ul>

## 9. Einordnung: Was der Chips Act 2.0 langfristig bedeutet

Der Chips Act 2.0 steht nicht allein. Er ist Teil eines breiteren Regulierungsrahmens, den die EU in den vergangenen Jahren aufgebaut hat: von der EU Machinery Regulation (2023/1230) über den Cyber Resilience Act bis zum European Defence Industrial Strategy. Die Stoßrichtung ist konsistent: Technologische Abhängigkeiten sollen schrittweise reduziert und die europäische Wertschöpfung gestärkt werden.

Für OEMs bedeutet das: Der Chips Act 2.0 ist kein isoliertes Ereignis. Vieles spricht dafür, dass Transparenz und Diversifizierung von Halbleiterlieferketten künftig weiter an Bedeutung gewinnen werden. Diese Entwicklung wird gleichermaßen durch verschärfte Compliance-Vorgaben, steigende Erwartungen der Endkunden sowie ein wachsendes Risikobewusstsein auf Managementebene getrieben.

Für viele OEMs dürfte daher weniger die Frage nach dem „Ob“ als vielmehr nach dem „Wann“ und „Wie“ eines strukturierten Lieferkettenmanagements im Vordergrund stehen. Wer beginnt, wenn es noch kein Muss ist, behält die Kontrolle über das Tempo und die Kosten.

## Fazit

Der Chips Act 2.0 — veröffentlicht am 3. Juni 2026 als Vorschlag der Europäischen Kommission — schafft erstmals eine nachfrageseitige Dimension in der EU-Halbleiterpolitik. OEMs, die öffentliche Auftraggeber oder kritische Infrastrukturbetreiber beliefern, sollten den Vorschlag als regulatorisches Signal verstehen und die Übergangszeit nutzen, um Lieferkettentransparenz herzustellen, Dual-Sourcing-Strukturen aufzubauen und die Zusammenarbeit mit europäischen EMS-Partnern zu stärken. Wer das heute tut, handelt nicht aus Compliance-Reflex, sondern aus strategischer Vorausschau.

## Quellen

Alle nachfolgenden Quellen sind frei und ohne Registrierung oder Bezahlschranke zugänglich.

- [1] European Commission. Proposal for the Chips Act 2.0. Brussels, 3 June 2026.
- [2] European Commission. Chips Act 2.0 – Policy Overview. Brussels, 3 June 2026.
- [3] European Commission. Strengthening Europe’s Tech Sovereignty. Press Release, 3 June 2026.
- [4] AENEAS. European Commission Unveils Proposed Chips Act 2.0. 3 June 2026.
- [5] Silicon Saxony. Europe Publishes First Proposal for Chips Act 2.0. 3 June 2026.
- [6] PwC. Semiconductor Industry Outlook: Global Semiconductor Market Expected to Exceed USD 1 Trillion by 2030. Accessed June 2026.
- [7] EE News Europe. Chips Act 2.0 Targets European Chip Demand. 2026.
- [8] European Parliament. Priority Question P-002327/23: PCB Industry and Strategic Autonomy of Europe. July 2023.
- [9] World Trade Organization (WTO). Information Technology Agreement (ITA).

### Über den Autor

Dirk Kaussen ist Gründer und Geschäftsführer der EMS Strategy Group. Mit rund 40 Jahren Erfahrung in der Elektronikindustrie — darunter die Gründung einer eigenen Elektronikfertigung in Deutschland — verfügt er über tiefgreifende Expertise in Fertigungsprozessen, EMS-Partnerauswahl, Lieferkettenstabilität, Verlagerungsprojekten und Risikomanagement. Sein Ansatz verbindet praxisnahe Lösungen mit direktem Bezug zur industriellen Realität.

### Über die EMS Strategy Group

Die EMS Strategy Group unterstützt Industrieunternehmen bei der strategischen und operativen Weiterentwicklung ihrer Elektronikfertigung. Schwerpunkte sind die Verlagerung zu europäischen EMS-Dienstleistern, der Aufbau neuer Fertigungskapazitäten, die Erweiterung bestehender Strukturen sowie die Sicherung der Lieferkette durch Risikoanalysen, Dual-Sourcing-Konzepte und belastbare Supply-Chain-Strukturen. Die Begleitung erfolgt operativ – von der strategischen Entscheidung bis zum Serienhochlauf. Im Mittelpunkt stehen Praxisnähe, Umsetzbarkeit und die industrielle Realität der Elektronikfertigung.

[www.emssg.com](http://www.emssg.com) | [LinkedIn: Dirk Kaussen](#)

### Rechtlicher Hinweis / Haftungsausschluss

Die in diesem White Paper enthaltenen Informationen, Analysen und Empfehlungen wurden mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Sie dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken im B2B-Kontext und stellen keine Rechts-, Steuer-, technische oder betriebswirtschaftliche Beratung dar, die auf eine spezifische Situation zugeschnitten ist. Die Inhalte dieses Dokuments können und sollen eine individuelle, qualifizierte Fachberatung oder wirtschaftliche Machbarkeitsstudien nicht

ersetzen. Alle genannten Markt-, Statistik- und Brancheninformationen basieren auf öffentlich zugänglichen Quellen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.

**Regulatorischer Vorbehalt:** Da sich gesetzliche Vorgaben, Richtlinien, Normen und deren offizielle Auslegungsvorschriften (insbesondere auf EU- und internationaler Ebene) kontinuierlich weiterentwickeln, spiegeln alle Angaben den Stand zum Zeitpunkt der Erstellung wider. Sie stehen unter dem ausdrücklichen Vorbehalt späterer offizieller Veröffentlichungen oder Gesetzesänderungen. Ausschließlich die offiziellen Gesetzestexte und behördlichen Publikationen sind rechtsverbindlich.

**Gewährleistungs- und Haftungsausschluss:** Obwohl alle zumutbaren Anstrengungen unternommen wurden, um die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen zu gewährleisten, übernimmt die EMS Strategy Group keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte.

Soweit gesetzlich zulässig, ist jegliche Haftung der EMS Strategy Group für direkte, indirekte, zufällige, Folge- oder sonstige Schäden ausgeschlossen, die aus der Nutzung, dem Vertrauen auf oder der praktischen Umsetzung von Informationen, Strategien, Empfehlungen oder Bewertungskriterien dieses White Papers entstehen.

**Urheberrecht und Weitergabe:** Dieses White Paper darf in seiner ursprünglichen, unveränderten Form weitergegeben und geteilt werden, vorausgesetzt, die vollständige Nennung und Urheberbezeichnung der EMS Strategy Group bleibt jederzeit erhalten.



[www.emssg.com](http://www.emssg.com) | LinkedIn: Dirk Kaussen

© 2026 EMS Strategy Group. Alle Rechte vorbehalten. Dieses White Paper darf mit Quellenangabe frei zitiert werden.